

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2025年6月19日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2025年6月12日通过电子邮件的方式送达公司全体董事。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中，独立董事郭建南先生、独立董事沈锦霞女士、董事康耀伦先生、董事何正宇先生、董事丁晓琼女士以通讯表决方式参加会议）。会议由董事长杨裕镜先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议表决，审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

为满足业务发展需要，董事会同意公司向厦门国际银行股份有限公司上海分行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 18,750.00 万元（含人民币 18,750.00 万元）、向富邦华一银行有限公司上海临港新片区支行申请一年期综合授信额度最高不超过人民币 10,000.00 万元（含人民币 10,000.00 万元），用于办理各类融资业务，包括但不限于开立银行承兑汇票、保函、信用证、流动资金贷款、保理 e 融、商业承兑汇票贴现等综合业务。上述授信额度均为纯信用无担保方式，具体授信方案以银行实际审批通过结果为准。公司董事会授权公司董事长或其授权人具体组织实施并签署相关合同及文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于申请银行

授信额度的公告》。

表决结果：同意 9 票，弃权 0 票，反对 0 票。

回避表决情况：无。

三、备查文件

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

惠柏新材料科技（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 19 日